Molex 503480-0600 PDF

深圳创唯电子有限公司

http://www.molex-connect.com

molex **SALES PACKAGING SPECIFICATION** molex

LANGUAGE
JAPANESE
ENGLISH

１． PRODUCT NAME：0.5 FPC CONN. E/O BACKFLIP H=1.0MM ASSEMBLY
EMBOSSED TAPE PACKAGING

PART NUMBER： ５０３４８０－＊＊００
５０３４８０－＊＊２０ (SHARP TYPE)
（＊＊ IS CIRCUITS SIZE）

２． STANDARD PACK QUANTITY

CKT. SIZE	CARRIER TAPE WIDTH (mm)	QTY. PER REEL	SHIPPING CARTON	
			NUMBER OF REELS	QUANTITY
4	16	3,000	7	21,000
5				
6				
8				
10				
12				
14	24	3,000	6	18,000
16				
17				
18				
20				
22				
24				
26				
32	32	3,000	5	15,000

REV.	K
SHEET	ALL

REVISE ON PC ONLY

REV.	DESCRIPTION
K	REVISED 614699 2019/04/01 YRKIM

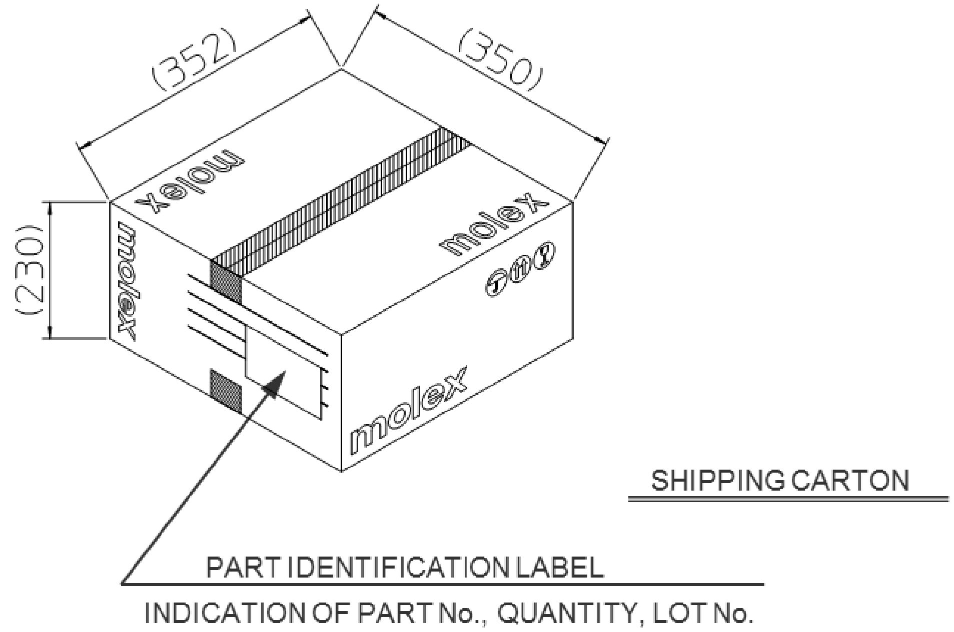
TITLE: SALES PACKAGING SPEC. FOR 503480

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DESIGN CONTROL	STATUS	WRITTEN BY:	CHECKED BY:	APPROVED BY:	DATE : YR/MO/DAY
KOR	M	YRKIM	KSKIM	YKIM02	2019/04/01

DOCUMENT NUMBER	FILE NAME	SHEET
SPK-503480-001	SPK503480001.doc	1 of 2

３.CARTON OUTER DIMENSIONS (REFERENCE PURPOSE ONLY)



REVISE ON PC ONLY		TITLE: SALES PACKAGING SPEC. FOR 503480
K	SEE SHEET 1 OF 2	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
REV.	DESCRIPTION	

DOCUMENT NUMBER		FILE NAME	SHEET
SPK-503480-001		SPK503480001.doc	2 of 2

molex **PRODUCT SPECIFICATION** molex	LANGUAGE	JAPANESE ENGLISH

【1. 適用範囲 SCOPE】

本仕様書は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿殿　に納入する＿0.5 mm ピッチ FPC用 コネクタ＿について規定する。

This specification covers the 0.5mm PITCH FPC CONNECTOR series.

【2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER】

製品名称 Product Name	製品型番 Material Number
ハウジング アッセンブリ Housing Assembly R/A (Upper or Lower Contact)	503480－＊＊09
テーピング梱包品（オーダー番号） Embossed Tape Package (ORDER No.)	503480－＊＊00

＊＊：極数（図面参照）
CIRCUITS (Refer to the drawing)

【3. 定 格 RATINGS】

項目 Item	規格 Standard	
最大許容電圧 Rated Voltage(MAXIMUM)	50 V	[AC(実効値 rms) / DC]
最大許容電流 Rated Current (MAXIMUM)	0.5A	
使用温度範囲 Operating Temperature Range	-40°C ~ + 85°C *1*2*3	
梱包保管 Storage Condition	温度 Temperature	+5℃~+35℃
	期間 Terms	出荷後6ヶ月（未開封の場合） For 6 months after shipping (unopened package)

*1：基板実装後の無通電状態は、使用温度範囲が適用されます。
Non-operating connectors after reflow must follow the operating temperature range condition.

*2：通電による温度上昇分を含む。
This includes the terminal temperature rise generated by conducting electricity.

*3：適合FPC(電線、ケーブル等)も本使用温度範囲を満足すること。
Applicable FPC (wires and cables) must also meet the specified temperature range.

REV.	E					
SHEET	ALL					
REVISE ON PC ONLY		TITLE: 0.5 FPC CONN E/O BACKFLIP H=1.0MM 製品仕様書				
E	変　更 REVISED KOR2015-0144 2015/04/　YRKIM					
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				
DESIGN CONTROL J	STATUS	WRITTEN BY: T.HIRAYAMA	CHECKED BY: N.MATSUURA	APPROVED BY: K.MORIKAWA	DATE: YR/MO/DAY 2009/12/11	
DOCUMENT NUMBER **PS-503480-001**					FILE NAME PS503480001.doc	SHEET 1 OF 15

【4. 性　　能 PERFORMANCE】

4-1. 電気的性能 Electrical Performance

項　　目 Item		条　　　　　件 Test Condition	規　　　格 Requirement
4-1-1	接触抵抗 Contact Resistance	適合FPCを嵌合させ、開放電圧 20mV以下、短絡電流 10mA以下にて測定する。 (JIS C5402 5.4) Mate applicable FPC, measure by dry circuit, 20mV MAXIMUM, 10mA MAXIMUM. (JIS C5402 5.4)	100 milliohms MAXIMUM / pin
4-1-2	絶縁抵抗 Insulation Resistance	適合FPCを嵌合させ、隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に DC 500V を印加し測定する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302) Mate applicable FPC and apply 500V DC between adjacent terminals or terminal and ground. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302)	50 Megaohms MINIMUM
4-1-3	耐電圧 Dielectric Strength	適合FPCを嵌合させ、隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に AC 200V (実効値)を1分間印加する。 (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Mate applicable FPC and apply 200V AC for 1 minute between adjacent terminals and ground. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	異状なきこと No Breakdown

4 - 2. 機械的性能 Mechanical Performance

項　　目 Item		条　　　　　件 Test Condition	規　　　格 Requirement
4-2-1	FPC保持力 FPC Retention Force	適合FPCを挿入し、アクチュエータを閉じた状態にてFPCを毎分25±3 mmの速さで嵌合軸方向に対して真っ直ぐ引き抜く。 Insert the FPC, close the actuator, pull the FPC at the speed rate of 25±3mm per minute.	第6項参照 Refer to paragraph 6
4-2-2	端子保持力 Terminal/Housing Retention Force	ハウジングに装着された端子を引き抜く。 Apply axial pull out force on the terminal assembled in the housing.	0.2 N MINIMUM {20 gf MINIMUM}

4-3. そ　の　他 Environmental Performance and Others

項　目 Item		条　件 Test Condition	規　格 Requirement	
4-3-1	アクチュエータ繰返し動作 Repeated Actuator Open/Close	1分間に10回以下の速さでFPCの挿入、アクチュエータの開閉、FPCの抜去の動作を10回繰り返す。 Insert FPC, close and open actuator , withdraw FPC to 10 cycles, at the speed rate of less than 10 cycles / minute.	接触抵抗 Contact Resistance	120 milliohms MAXIMUM
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	適合するFPCを嵌合させ、最大許容電流を通電し、コネクタの温度上昇分を測定する。 (UL 498) Mate applicable FPC and measure the temperature rise of contact when the maximum AC rated current is passed. (UL 498)	温度上昇 Temperature Rise	30 degree C MAXIMUM
4-3-3	耐振動性 Vibration	DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な3方向に掃引割合10～55～10 Hz/分、全振幅 1.5mm の振動を各 2時間 加える。 (MIL-STD-202試験法 201) Mate applicable FPC and subject to the following vibration conditions, passing DC 1mA current during the test. Amplitude : 1.5 mm P-P Frequency : 10-55-10 Hz / minute. Duration : 2 hours in each 3 mutually perpendicular axes (MIL-STD-202, Method 201)	外観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	120 milliohms MAXIMUM
			瞬　断 Discontinuity	1.0 microsecond MAXIMUM
4-3-4	耐衝撃性 Mechanical Shock	DC 1mA通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な6方向に、490m/s^2 {50G}の衝撃を作用時間11millisecondで各3回加える。 (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 試験法 213) Mate applicable FPC and subject to the following shock conditions. 3 times of shocks shall be applied for each 6 directions along 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1mA current during the test. (Total of 18 shocks) Test pulse : Half Sine Peak value : 490m/s^2 {50G} Duration : 11 milliseconds (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 Method 213)	外観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	120 milliohms MAXIMUM
			瞬　断 Discontinuity	1.0 microsecond MAXIMUM

項　目 Item		条　　件 Test Condition	規　　格 Requirement	
4-3-5	耐熱性 Heat Resistance	適合するFPC嵌合させ、85±2℃の雰囲気中に96時間放置後取り出し、1～2時間室温に放置する。 (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 試験法 108) Mate applicable FPC and expose to 85±2 degree C for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 Method 108)	外観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	120 milliohms MAXIMUM
4-3-6	耐寒性 Cold Resistance	適合するFPCを嵌合させ、-40±3℃の雰囲気中に96時間放置後取り出し、1～2時間室温に放置する。 (JIS C60068-2-1) Mate applicable FPC and expose to -40±3 degree C for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-1)	外観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	120 milliohms MAXIMUM
4-3-7	耐湿性 Humidity	適合するFPCを嵌合させ、40±2℃、相対湿度90～95%の雰囲気中に96時間放置後、取り出し、1～2時間室温に放置する。 (JIS C680068-2-3/MIL-STD-202 試験法103) Mate applicable FPC and expose to 40±2 degree C, relative humidity 90 to 95% for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 Method 103)	外観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	120 milliohms MAXIMUM
			耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3項　満足のこと Must meet 4-1-3
			絶縁抵抗 Insulation Resistance	20 Megaohms MINIMUM

項　目 Item		条　　件 Test Condition	規　格 Requirement	
4-3-8	温度サイクル Temperature Cycling	適合するFPCを嵌合させ、-55±3℃に30分、+85±2℃に30分、これを1サイクルとし5サイクル繰り返す。但し、温度移行時間は5分以内とする。試験後、1～2時間室温に放置する。 (JIS C0025) Mate applicable FPC and subject to the following conditions for 5 cycles. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditions at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. 1cycle a) -55±3 degree C 30 min. b) +85±2 degree C 30 min. Transit time shall be within 5 min. (JIS C0025)	外観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	120 milliohms MAXIMUM
4-3-9	塩水噴霧 Salt Spray	適合するFPCを嵌合させ、35±2℃にて5±1%重量比の塩水を48時間噴霧し試験後常温で水洗いした後、室温で乾燥させる。 (MIL-STD-1344) Mate applicable FPC and exposed to the following salt mist conditions. Upon completion of the exposure period, salt deposits shall be removed by a gentle wash or dip in running water, after which the specified measurements shall be performed. NaCl solution Concentration: 5±1% Spray time: 48 hours Ambient temperature: 35±2 degree C (MIL-STD-1344)	外観 Appearance	割れ、著しい腐食等異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	120 milliohms MAXIMUM
4-3-10	亜硫酸ガス SO_2 Gas	適合するFPCを嵌合させ、40±2℃、50±5ppmの亜硫酸ガス中に24時間放置する。 Mate applicable FPC and expose to 50±5ppm SO_2 gas at 40±2 degree C for 24 hours.	接触抵抗 Contact Resistance	120 milliohms MAXIMUM
4-3-11	耐アンモニア性 NH_3 Gas	適合するFPCを嵌合させ、濃度28%のアンモニア水を入れた容器中に40分間放置する。 Mate applicable FPC and expose to NH_3 gas evaporating from 28 % for 40 minutes.	接触抵抗 Contact Resistance	120 milliohms MAXIMUM

項　　目 Item		条　　　　件 Test Condition	規　　　格 Requirement	
4-3-12	半田付け性 Solderability	ターミナルおよび金具先端より0.2mmの位置まで245±3℃の半田に3±0.5秒浸す。 Dip solder tails and nails into the molten solder (held at 245±3 degree C) up to 0.2mm from the tip of tails and nails for 3±0.5 sec.	濡れ性 Solder Wetting	浸漬面積の95%以上 95% of immersed area must show no voids, pinholes
4-3-13	半田耐熱性 Resistance to soldering Heat	赤外線リフロー時 (Reflow by Infrared Reflow Machine) 第7項の推奨温度プロファイル条件にて、2回リフローを行う。 Using the reflow profile condition below paragraph 7, reflow test specimens twice. 手半田時 (Reflow by Manual Soldering iron) 端子先端、及び金具先端より0.2mmの位置まで、350±10℃の半田ゴテにて5秒加熱する。但し、異常な加圧のないこと。 Using a soldering iron (350±10 degrees C for 5 seconds) heat up the area 0.2mm from the tip of the solder tails and fitting nails. However, do not apply excessive pressure to either the terminals or fitting nails.	外観 Appearance	端子ガタ、割れ等異状なきこと No Damage

（　　）:参考規格
:Reference Standard

＊各項目の評価サンプルは、製品図面に記載されている推奨基板レイアウト、推奨メタルマスクにて実装しています。リフロー条件は4-3-13の推奨温度プロファイルにて実装しております。半田ペーストは、無鉛半田（Sn-3Ag-0.5Cu）を使用しています。
The evaluation samples of each specification test are reflowed according to the recommended Print Circuit Board layout and the recommended metal mask thickness specified in the sales drawing. The reflow conditions followed are specified in the reflow profile in section 4-3-13. Lead free solder (Sn-3Ag-0.5Cu) was used as the soldering paste.

【5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS】

図面参照
Refer to the drawing.

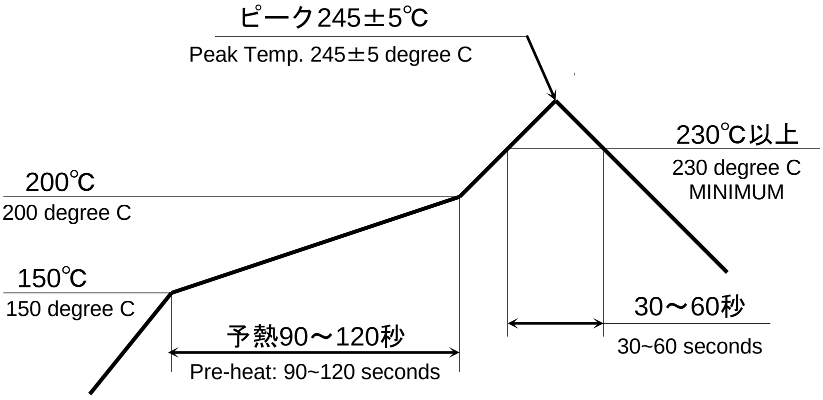
【6. FPC保持力 FPC RETENTION FORCE】

厚みt=0.3 mmのFPCを使用した時のデータ値
This test date in case of used the FPC(t=0.3 mm)

極数 CIRCUIT	単位 UNIT	保持力（最小値） DATA (MINIMUM)	
		初回 1st	10回目 10th
4	N [gf]	1.08 [110]	0.69 [70]
5	N [gf]	1.30 [132]	0.90 [92]
6	N [gf]	1.62 [165]	1.04 [106]
8	N [gf]	2.16 [220]	1.38 [141]
10	N [gf]	2.70 [275]	1.72 [176]
12	N [gf]	3.24 [330]	2.07 [211]
14	N [gf]	3.77 [385]	2.41 [246]
16	N [gf]	4.31 [440]	2.76 [282]
17	N [gf]	4.58 [468]	2.93 [299]
18	N [gf]	4.85 [495]	3.10 [317]
20	N [gf]	5.39 [550]	3.45 [352]
22	N [gf]	5.81 [593]	3.79 [387]
24	N [gf]	6.30 [642]	4.0 [407]
26	N [gf]	6.64 [678]	4.46 [455]
32	N [gf]	7.88 [804]	5.49 [560]

＊FPCの仕様により保持力が影響を受ける為、規格を満たさない事があります。
There may be the case which the connector performance does not meet the above specification, because the different FPC manufacturers have their own unique specification.

【7. 赤外線リフロー条件　INFRARED REFLOW CONDITION】



温度条件グラフ
<u>TEMPERATURE CONDITION GRAPH</u>

注記
NOTES

1. 本リフロー条件に関しては、温度プロファイル、半田ペースト、大気、N2リフロー、基板などにより条件が異なりますので事前に実装評価(リフロー評価) を必ず実施願います。実装条件によっては、製品性能に影響を及ぼす場合があります。
Please investigate the mounting condition (reflow soldering condition) on your own devices beforehand. The mounting conditions may change due to the soldering temperature, soldering paste, air reflow machine, Nitrogen reflow machine, and the type of printed circuit board.　The different mounting conditions may have an influence on the product’s performance

2. 温度条件は、半田接合部（基板表面）とする。
Let temperature conditions be the solder joint of connector.

【8. 実装上の注意　INSTRUCTION UPON MOUNTING】

1. 実装性能（平坦度）は、実装基板の反りの影響を含まないものと致します。
   基板の反りはコネクタ両端部を基準とし、コネクタ中央部にて Max0.02mmとして下さい。
   The mounting specification for coplanarity does not include the influence of warpage of the printed circuit board.　The warpage of the printed circuit board should be a maximum of 0.02mm if measuring from one connector edge to the other.

2. 本製品の一般性能確認はリジット基板にて実施しております。
   フレキシブル基板等の特殊な基板へ実装する場合は、事前に実装確認等を行った上でご使用願います。
   The product performance was tested using rigid printed circuit board. In case the product needs to be reflowed onto flexible circuit board, please conduct a reflow test on the flexible circuit board in advance.

3. フレキシブル基板に実装する場合は、基板の変形を防止するため、補強板をご使用願います。
   Please add a stiffener on the flexible printed circuit (FPC) when you mount the connector onto FPC in order to prevent deformation of the FPC.

4. リフロー後、半田付け部に変色が見られることがありますが、製品性能に影響はありません。
   Although there might be some discoloration seen on the soldering tail after reflow, this will not influence the product’s performance.

5. 半田実装部の未半田は、ターミナル脱落、ピン間ショート、ターミナル座屈、またコネクタの基板からの外れが懸念されます。従って全てのターミナルテール部及び、ネイル部に半田付けを行って下さい。
   If you leave any soldering area on this product open, there may be the possibility of a missing terminal short circuiting between pins, terminal buckling or the potential for the connector to come off of the printed circuit board.　Therefore, please solder all of the terminals and fitting nails on the printed circuit board.

6. FPCの取り回し方によって、FPCの抜け、接触不良等が発生する可能性があります。御社基板のレイアウト上、コネクタに負担の掛かる位置への取り付けはしないで下さい。
   It may cause to come off FPC, and/or occur contact defect by cabling the FPC in your application. Please make sure to avoid placing the connector where the connector is affected from the excessive force by your printed circuit board Layout reason.

【9. 使用上の注意　INSTRUCTION UPON USAGE】

1. コネクタの性能を損なう恐れがある為、コネクタの洗浄は、行わないで下さい。
   Please do not conduct any “washing process” on the connector because it may damage the product’s function.

2. 適合するFPCの導体部は、金めっき（ニッケル下地）品をご使用願います。
   Please make sure to use the appropriate FPC which has Gold plating (Nickel under plating) on the contact area.

3. 量産前にご使用になるFPCとの相性確認を行った上で、ご使用願います。
   Please check the compatibility between the connector and the FPC before mass production.

4. コネクタにFPCを装着した状態で、FPCに過度の負荷が加わらないように注意して下さい。コネクタのロックが解除されたり、FPCが断線、破損したりする原因になります。特に、連続的に加わる場合はFPCを固定するようにして下さい。また、基板に対して垂直上方向の引張荷重、コンタクトピッチ方向のこじり荷重を与えない様にご注意願います。
   Please pay special attention not to add the excessive force on the FPC under the FPC inserted condition. It may cause to unlock the connector, break the FPC, and/or damage the FPC. Especially, in case the consecutive force on the FPC is added in your application, fix the FPC. Please avoid the vertical pulling force to direction of the PCB(rigid epoxy-glass printed circuit board). Also avoid twisting the FPC to the direction of contact pitch.

5. 本製品をご使用時に取り付けられた電線・プリント基板の共振や、機器の回転構造や可動部分の動作によりコネクタ嵌合部（接点部）が常に動いてしまう状態での御使用は避けて下さい。接触部の摺動磨耗等による 接触不良の原因となります。 従って、機器内で電線・プリント基板を固定し、共振を抑える等の処置をお願い致します。Please do not use the connector in a condition where the wire, the printed circuit board, or the contact area is experiencing a sympathetic vibration of wires and printed circuit board, and constant movement of devices.　This may cause a defect in the contact due to the contact area being worn down.　Therefore, please fix wires and printed circuit board on the chassis, and reduces sympathetic vibration.

6. 基板実装前後に端子、補強金具に触れないで下さい。
   Please do not touch the terminals and fitting nails before and after reflowing the connector onto the printed circuit board.

7. アクチュエータの開閉は、コネクタを基板に実装しFPCを挿入した状態で行って下さい。
   FPCを挿入しない状態でのアクチュエータの開閉は、アクチュエータが外れる恐れがありますので
   行なわないで下さい。また、端子へのダメージも考えられます。
   Please open and close the actuator with the connector is mounted on the p.c.board, and the FPC inserted. The actuator might not come off from the opening and shutting of the actuator in the state that FPC is not inserted and do not do, please. And there is possibility of damaging terminals.

8. FPC挿入する際は、アクチュエータが完全に開いた状態で行い、FPCがハウジングに突き当たるまで確実に挿入して下さい(図-1参照)。左右斜めの状態で挿入すると、ピッチずれによるショート不良になったり、角がターミナルに引っ掛かりターミナルの変形やFPC導体めくれに至るケースがあります(図-2参照)。
When inserting the FPC into the connector, please ensure that the actuator is completely open during insertion. Please also ensure that the FPC is completely inserted until the end of the FPC touches the housing (See Figure 1). Diagonal insertion of the FPC into the connector can cause a short circuit due to the misaligned pitch. Diagonal insertion can also deform the terminal and/or damage the FPC contact area because the FPC edge may contact the terminal (See Figure 2).

水平挿入 ○
Horizontal insertion ○

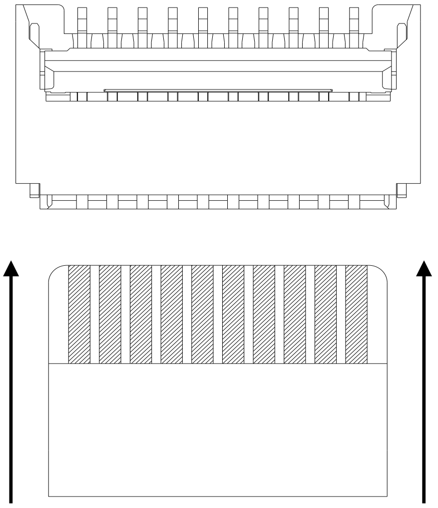


図-1(Figure 1)

斜め挿入 ×
Diagonal insertion ×

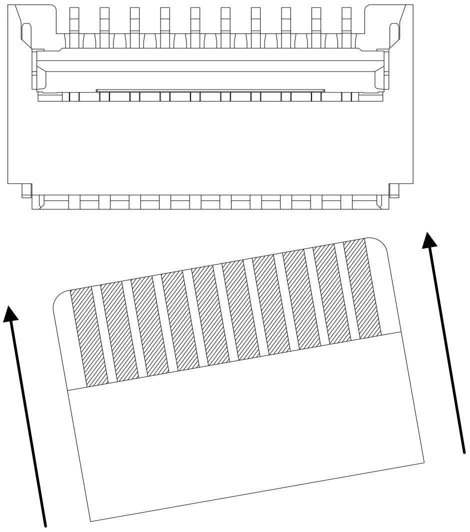


図-2(Figure 2)

9. アクチュエータ操作時にはピンセット等の先端が鋭利な物は使用しないで下さい。
コネクタの破損、半田付け部の損傷の原因になります。
When opening and closing the actuator, please do not use a sharp edged tool such as tweezers.
This may cause to damage the connector or to the soldering area.

10. アクチュエータを開閉する際は、左右均等に力が加わるように中央部を回転させて丁寧に操作する様に、お願いします（図-3参照）。荷重が一点に集中するような片側に偏った位置での操作は行わないで下さい（図-4参照）。コネクタの破損の原因になります。
When opening and closing the actuator, please gently pull the center of the actuator by applying an even force across the actuator and rotating carefully. (See Figure 3) Please do not apply a force only to one side of actuator because it may cause to damage the connector. (See Figure 4)

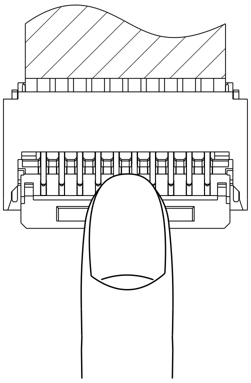


図-3(Figure 3)

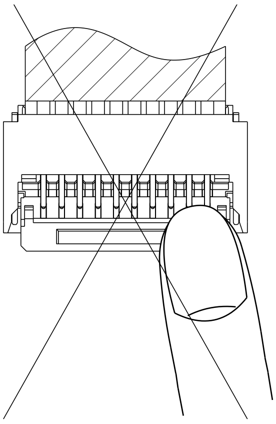
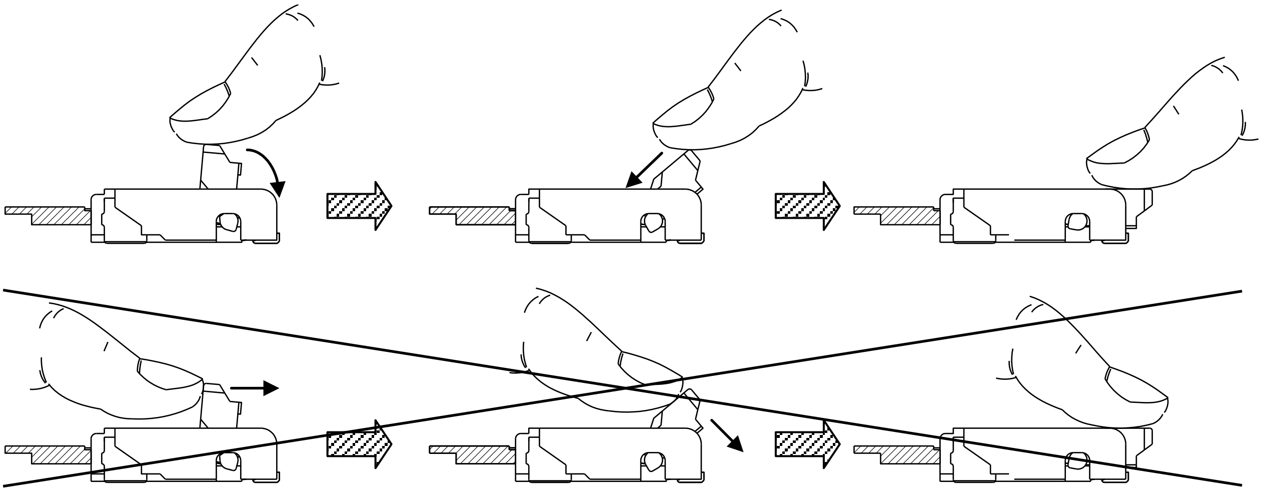
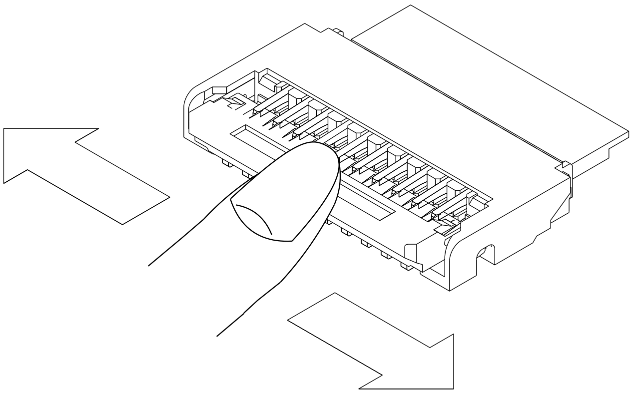


図-4(Figure 4)

11. アクチュエータを閉じる際は、下図の様に回転する方向に軽く荷重が掛かる様に閉じて下さい。
また、アクチュエータが外れる(押し出す)方向への負荷が加わらない様にご注意下さい。
破損・外れの原因となります。
When closing the actuator, please press down on the actuator with soft pressure in the direction of the rotary axis as shown in the figure below. Please do not push the actuator closed from the direction that the FPC is inserted. This may cause damage or disengagement of the actuator.



12. アクチュエータを閉じた後は、下図の様にアクチュエータを確実にロックする為に表面全体を軽く押さえて下さい。
After the actuator is closed , please press down the surface of actuator with soft pressure in order to lock as shown in the following figure.



13. アクチュエータのロックを解除する際は、アクチュエータの左右へ均等に力が加わるように、上方向へ押し上げて下さい。押し上げの際には、中央部を跳ね上げるように操作願います。アクチュエータが回転運動をして開きます。また、アクチュエータが変形及び破壊する方向（開く方向）への過大な負荷を掛けない様にご注意下さい。破損・外れの原因となります。
When unlocking the actuator, please pull up on the center of actuator in the direction of actuator rotation, which delivers even force to both edges of actuator. Please do not apply any force in any other direction as this may deform or damage the actuator.

14. FPCを抜く時は、アクチュエータが完全に開いた状態で行って下さい。万が一、アクチュエータが完全に開いていない状態でFPCを抜いた時は、コンタクト部に付着物が無いか確認の上、再装着願います。
When withdrawing the FPC, please make sure that the actuator is completely open. If the FPC is withdrawn without the actuator being fully open, please check to make sure that there is no debris on the contact area before inserting the FPC again.

【10. 外観　EXTERNALS】

1. 本製品の樹脂部に黒点、（ウエルド部の線）、多少の傷が確認される事がありますが、製品性能には影響ございません。
   Although this product may have a small black mark, a weld line or a scratch on the housing, these will not have any influence on the product’s performance.

2. 成形品の色相に多少の違いを生じる場合がありますが、製品性能には影響ありません。
   There may be slight differences in the housing coloring, but there will be no influence on the product’s performance.

3. アクチュエータに潤滑剤が乾いた時に起こる白い部分が発生することがありますが、製品性能に影響ありません。
   You may find the white dot on the actuator when the lubricant becomes dry, this will not affect the product’s performance.

4. ハウジングのＦＰＣ挿入間口に多少の反りが発生致しますが、電気的には影響ありません。（フードのそり）
   There is no influence electrically though a few warps will be generated in the FPC insertion width of the housing. (warp of hood)

5. 本製品のネイルは錫めっきを使用しているため、外観に摺動痕がつく場合が御座いますが、製品性能に影響はありません。
   Because we plate the fitting nails with Tin, there may be scratch marks on the surface. However, these scratches will have no influence on the product’s performance.

【11. リペア　REPAIR】

1. 実装後において半田ごてによる手修正を行う際は、必ず仕様書掲載の条件以内で行って下さい。条件を超えて実施した場合、端子の抜け、接点ギャップの変化、モールドの変形、溶融等、破損の原因になります。
   When conducting manual repairs using a soldering iron, please follow the soldering conditions shown in the product specification. If the conditions in the product spec are not followed, it may cause the terminals to fall off, a change in the contact gap, a deformation of the housing, melting of the housing, and damage the connector.

2. 半田こてによる手修正を行なう際、過度の半田やフラックスを使用しないで下さい。半田上がりやフラックス上がりにより接触、機能不良に至る場合があります。
   When conducting manual repairs using a soldering iron, please do not use more solder and flux than needed. This may cause solder wicking and flux wicking issues, and it will eventually cause a contact defect and functional issues.

【12. 環境指令への適合　COMPLIANCE WITH ENVIRONMENTAL DIRECTIVE】

1. ELV及びRoHS適合品
   ELV and RoHS Compliant

REV.	REV. RECORD	DATE	EC NO.	WRTTN:	CH'K:
A	RELEASED	09/12/11	J2010-1246	T.HIRAYAMA	N.MATSUURA
B	REVISED	10/02/22	J2010-1690	T.HIRAYAMA	N.MATSUURA
C	REVISED	10/04/29	J2010-2172	T.HIRAYAMA	N.MATSUURA
D	REVISED	10/08/30	J2011-0104	S.HIRATA	K.TAKAHASHI
E	REVISED	15/06/01	KOR2015-0144	YRKIM	KSKIM